

【Causes/processes involved/keys to judgment】

A foreign object or a chemical residue remaining between plated copper surface and dry film prevents the adhesion of dry film, causing etching of conductor . Poor adhesion of dry film attributable to a bulge around a dent also causes the same defect. (Dry film lamination - etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率× 10
【注釋】
显微镜倍率 × 10
【Comments】
Magnification: ×10

1-2-1-5 円形打痕欠け／圓形压痕的缺口／ Round nick by dent

【特徴】 欠けの淵に盛り上がりが見られ、裾が残っている欠け

【特征】 边缘隆起，有锯齿状的缺口。

【Characteristics】 There is a raised edge of a nick. The nick also has a tail.

【原因・判断ポイント・発生工程】 基板銅めっき面の円形打痕の淵が盛り上がった為、DFRの密着が妨げられ、ET液に食われてきたもの（DFRラミネート～ET工程）

【原因、判断要点、发生工序】 在板件的镀铜面有圆形压痕，其边缘隆起妨碍DFR的压合，被ET液腐蚀而发生的（DFR压～ET工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

The edge of a round dent on the plated copper surface of a base laminate is raised and prevents a close adhesion of dry film to cause etching of conductor . (Dry film lamination - etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率× 80
【注釋】
显微镜倍率 × 80
【Comments】
Magnification: ×80



【コメント】
顕微鏡倍率× 70
【注釋】
显微镜倍率 × 70
【Comments】
Magnification: ×70

1-2-1-6 糊残り欠け／胶迹的缺口／ Nick by residual adhesive

【特徴】 短絡や突起等と同居している複雑な欠け

【特征】 短路和凸出等同时存在的复杂形状的缺口。

【Characteristics】 A complicated nick together with shorts, spikes, etc.



【コメント】
顕微鏡倍率× 50
【注釋】
显微镜倍率 × 50
【Comments】
Magnification: ×50